

# Ersa Dip&Print Lotpastendruck-Station

Die Ersa **Dip&Print Station** ermöglicht dem Anwender von Ersa Rework-Systemen, die Bauteilvorbereitung (Auftrag von Lotpaste oder Flussmittel) einfach, zuverlässig und reproduzierbar vorzunehmen.

Optionale Dip-Schablonen erlauben es, Bauteile definiert in Flussmittel oder Lotpaste einzutauchen und so ein definiertes Depot an den Lötanschlüssen zu erzeugen. Dieses Verfahren eignet sich für BGA- und die meisten Fine-Pitch-Bauteile. Mit einer bauteilspezifischen Print-Schablone werden z. B. QFN/MLF-Anschlüsse und die anderer SMD-Komponenten einfach und präzise mit einem Lotpastendepot versehen.

Beim Print-Prozess wird das in die Schablone eingespannte Bauteil von unten mit Lotpaste bedruckt, um anschließend mittels der Platziereinheit aus der Schablone ausgehoben und platziert zu werden.

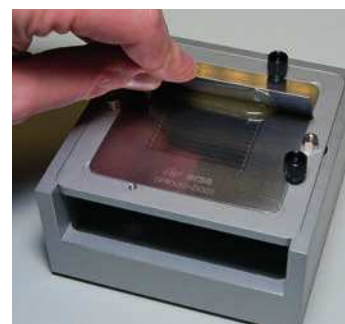
Für jedes Ersa Rework-System gibt es eine passende Rahmenfixierung zur Aufnahme des Schablonenrahmens der Dip&Print Station am Platziersystem.



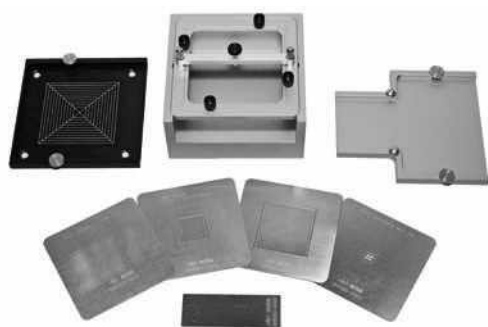
Bauteil ausheben aus Print-Schablone

## Funktionsmerkmale Dip&Print Station

- Einfache Bauteilbedruckung mit Lotpaste
- Bauteil-Dip-in für Lotpaste oder Flussmittel
- Passend zu allen Ersa Rework-Systemen
- Einfach wechselbare Schablonen
- Reinigungsfreundliche Teile



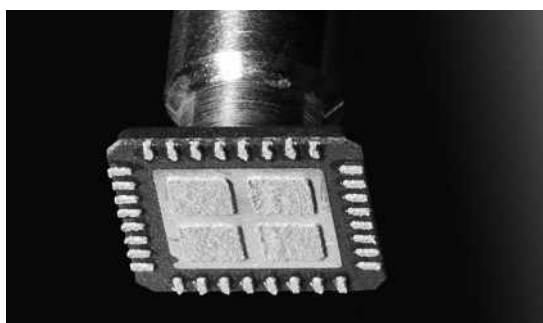
Flussmittelauftrag in Dip-Schablone



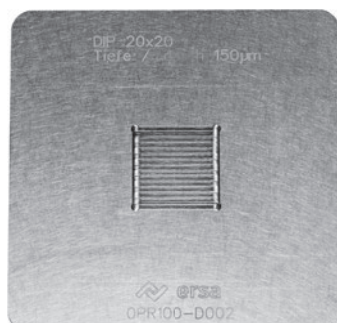
Dip&Print Station mit Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
OPR100	Dip&Print Station
OPR100-PL550	Rahmenfixierung für PL 550
OPR100-PL650	Rahmenfixierung für PL 650
OPR100-D001	Dip-Schablone, 40 x 40 mm / 300 µm
OPR100-D002	Dip-Schablone, 20 x 20 mm / 150 µm
OPR100-D003	Dip-Schablone, 20 x 20 mm / 100 µm

Print-Schablonen können aufgrund möglicher maßlicher Abweichungen an den Komponenten nur nach genauer vorheriger Klärung angeboten werden.



MLF 32 mit Lotpaste bedruckt



Dip-Schablone, 20 x 20 mm, 150 µm



Print-Schablone MLF 32